

層数 : 2
基材 : FR4
銅厚 : 1.57mm +/- 10 %
銅重 : 1oz
表面処理 : ENIG (Au : 2-5u ")
穴径 (mm) : 0.3, LPI (mm)
穴径 (mm) : 0.3, 0.4

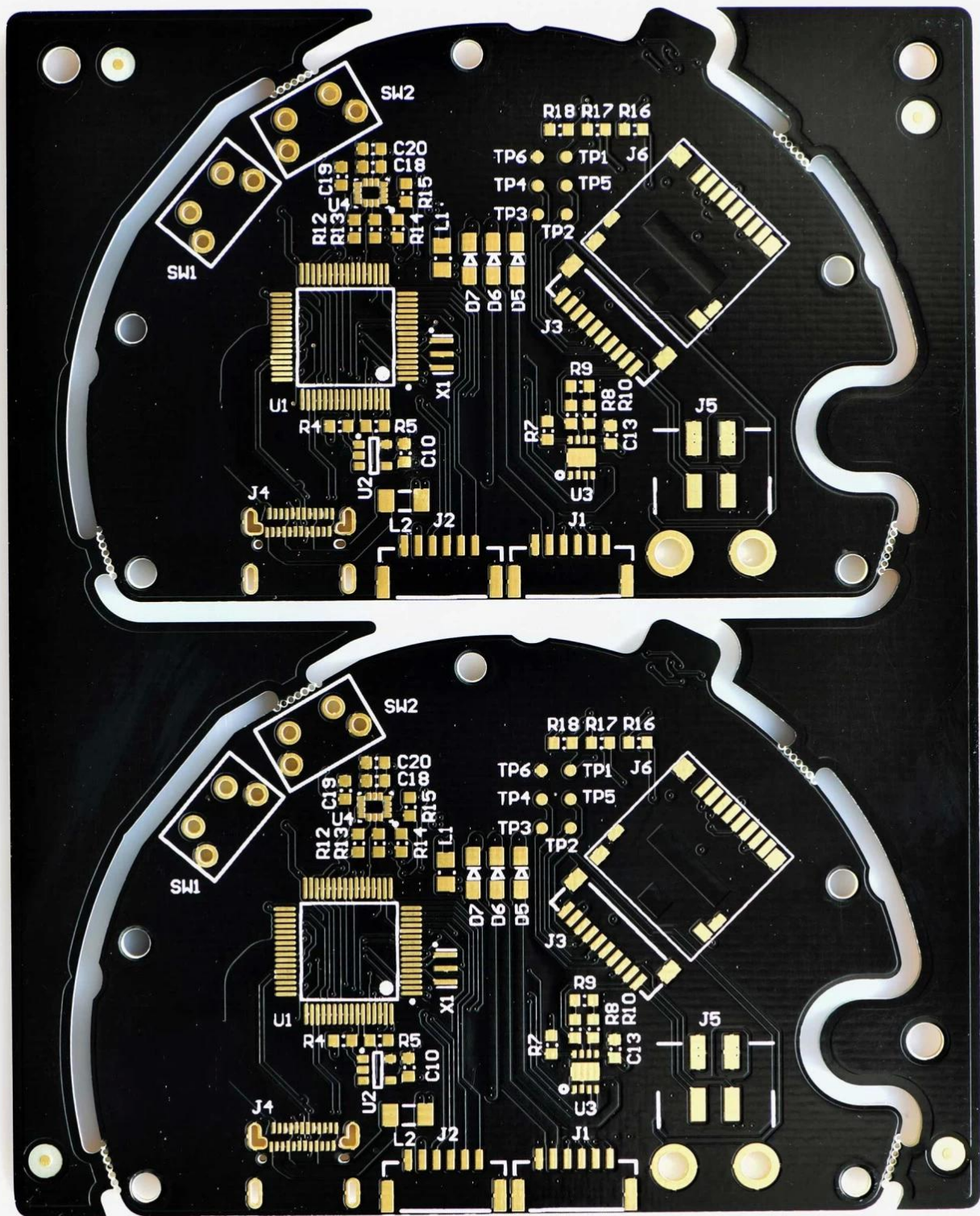
銅厚

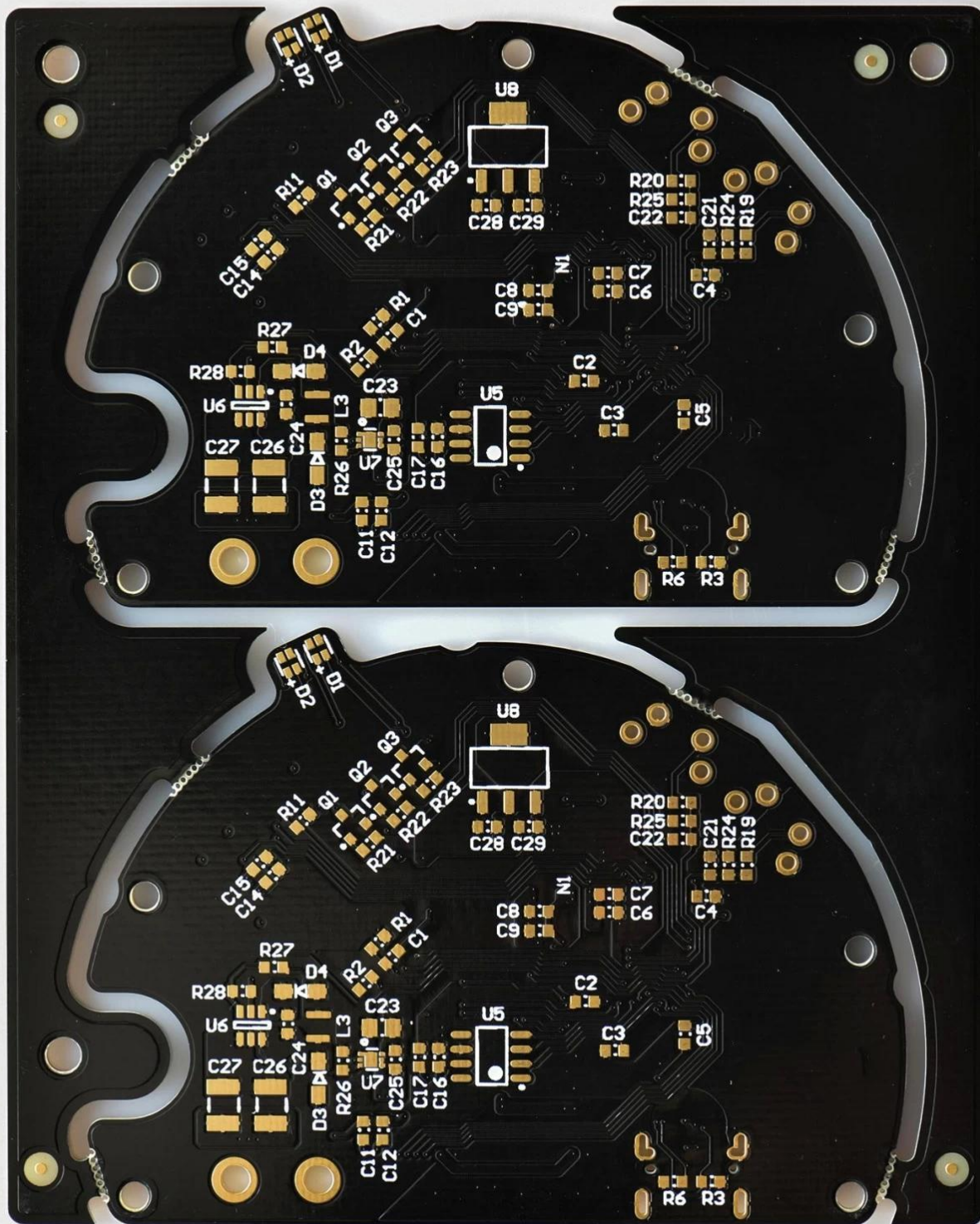
銅厚 : 0.050uM 3-6uM NICKEL IMMING GOLD PLATED
銅厚 .050uM 3-6uM NICKEL

銅厚 .025 AVG, .020 MIN .. 銅厚 .500 銅厚 銅厚 銅厚 銅厚 銅厚 銅厚

銅厚 :
=====
*.GM4 : 銅厚 銅厚
*.TXT : NC 銅厚 銅厚

*.GTP : 銅厚 銅厚 銅厚
*.GTO : 銅厚 銅厚 銅厚
*.GTS : 銅厚 銅厚 銅厚
*.GTL : 銅厚 銅厚 銅厚
*.GBL : 銅厚 銅厚 銅厚
*.GBS : Bottom Soldermask
*.GBO : 銅厚 銅厚 銅厚
*.GBP : 銅厚 銅厚 銅厚





pcb wholesales, 2000 2000 2000